

CRFシリーズ リードリレー



- 特長: 高密度実装用超小型SMDリレー、最大7GHzの高周波信号伝送対応、高絶縁抵抗
- セラミック/モールド一体型パッケージ、テープ & リール梱包対応
- 適用: 高周波信号、テスト計測機器、通信、マルチプレクサ

品名構成: CRF00-1AX (250)

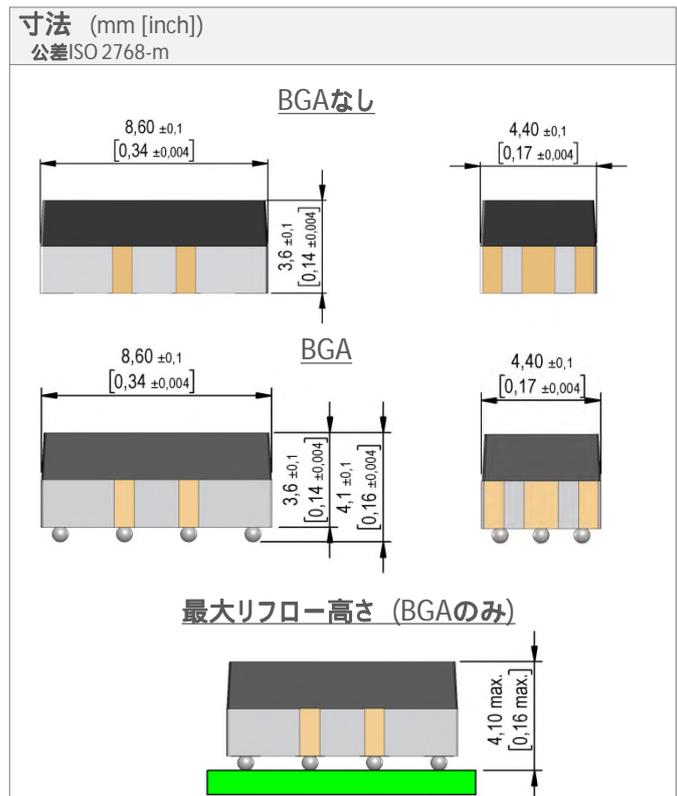
公称電圧	接点数	接点形式	オプション	梱包 テープ & リール
03, 05	1	A	空白 = BGAなし S = BGA (はんだボール)	空白 (標準) = 1000個 250 (オプション) = 250個
オプションは3ページ参照				

接点データ (20°C)	スイッチモデル	単位
	80	
接点材料	Rh	
定格電力 (max.) 接点印加電圧 × 電流	10	W
開閉電圧 (max.) DC, AC	170	V
開閉電流 (max.) DC, AC	0.5	A
通電電流 (max.) DC, AC	1.0	A
接触抵抗 (max.) @0.5V & 10mA, 140%励磁	200	mOhm
接点間耐電圧 (min.) IEC 60255-27	210	VDC
動作時間 (max.) バウンス含む, 140%励磁	0.6	ms
復帰時間 (max.) サージ吸収ダイオードなし	0.05	ms
絶縁抵抗 (min. / typ.) @<45%RH, 100V	10 ¹⁰ / 10 ¹¹	Ohm
接点間静電容量 (typ.) @10kHz	0.3 / 0.5	pF

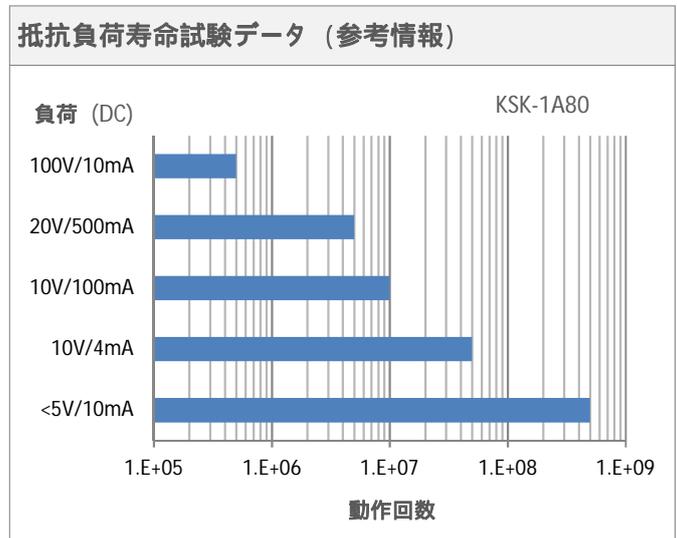
コイルデータ (20°C)		定格電圧 (VDC)		コイル抵抗 (Ohm)	動作電圧 (VDC)	開放電圧 (VDC)	定格消費電力 (mW)
接点 形式	スイッチ モデル	nom.	max.	typ. (± 10 %)	max.	min.	nom.
1A	80	03	05	70	2.25	0.45	129
		05	7.5	150	3.75	0.75	167

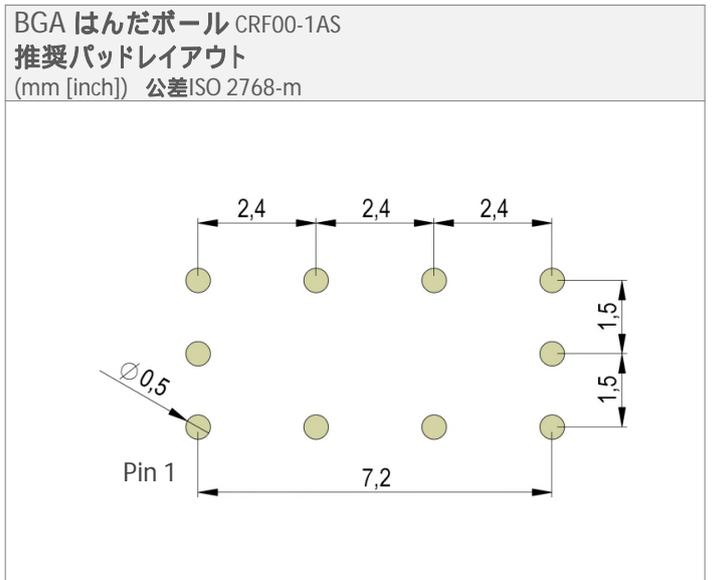
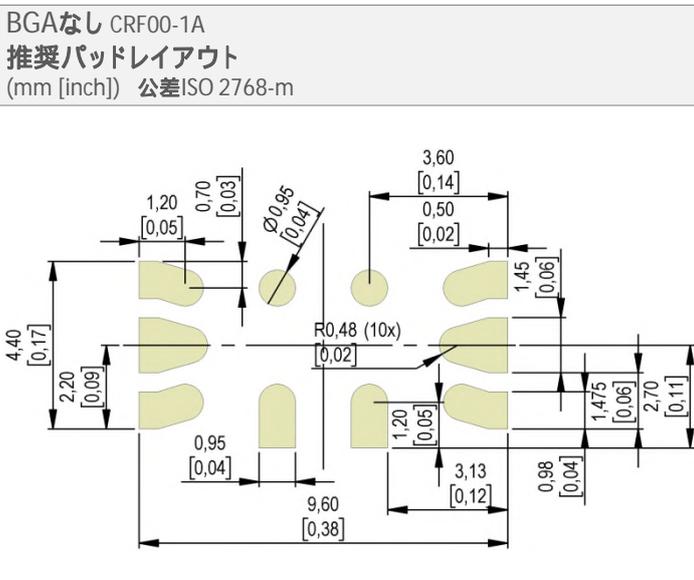
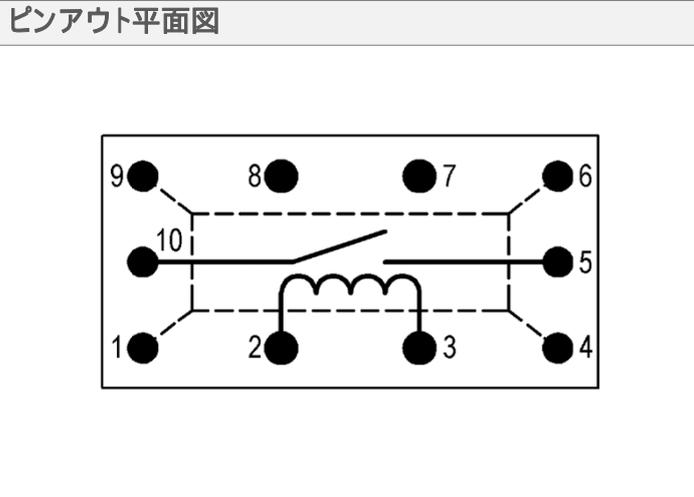
動作電圧、復帰電圧およびコイル抵抗は0.4%/°Cで変化

リレーデータ (20°C)		単位
接触抵抗 (typ./max.) セラミックおよび全ての導体を含む	260 / 440	mOhm
絶縁耐力 コイル/接点 (min.) IEC 60255-27	1.5	kVDC
絶縁抵抗 コイル/接点 (typ./min.) @ <45%RH, 200V	10 ¹² / 10 ¹³	Ohm
電気容量 コイル/接点 (typ./max.) @ 10 kHz	0.9 / 1.1	pF
耐衝撃 (max.) 半波正弦波, 11ms, 3軸	50	G
耐振動 (max.) 10 – 2,000 Hz	20	G
動作温度 (max.) リレーハウジング周囲	-40 to 125	°C
保存温度 (max.) リレーハウジング周囲	-55 to 125	°C
はんだ付け温度 5 sec. max.	255	°C
洗浄性 水洗後、要乾燥	完全密閉	



- 取り扱いおよび組み立てにおける注意事項
- 誘導性または容量性の負荷をスイッチングすると逆起電圧や突入電流のピークが発生し、リレーに損傷を与えることがあります。これらを防止するために適切な保護回路が必要です。弊社ホームページをご覧ください。
 - リレーを隣接して高密度実装した場合の磁気干渉や外部磁界がリレーの電気特性に影響を及ぼすことがありますので、これらを十分考慮した設計が必要です。
 - リレーを落下させるなどの機械的衝撃は、リレーの電気特性に悪影響を及ぼすことがあります。
 - サージ吸収ダイオードを使用した場合、復帰時間に遅れが生じます。
 - リフローはんだ付けの推奨プロファイルは4ページを参照ください。はんだペーストメーカー推奨条件や実装装置および実装部品の耐熱なども考慮の上、最適条件を十分ご確認ください。



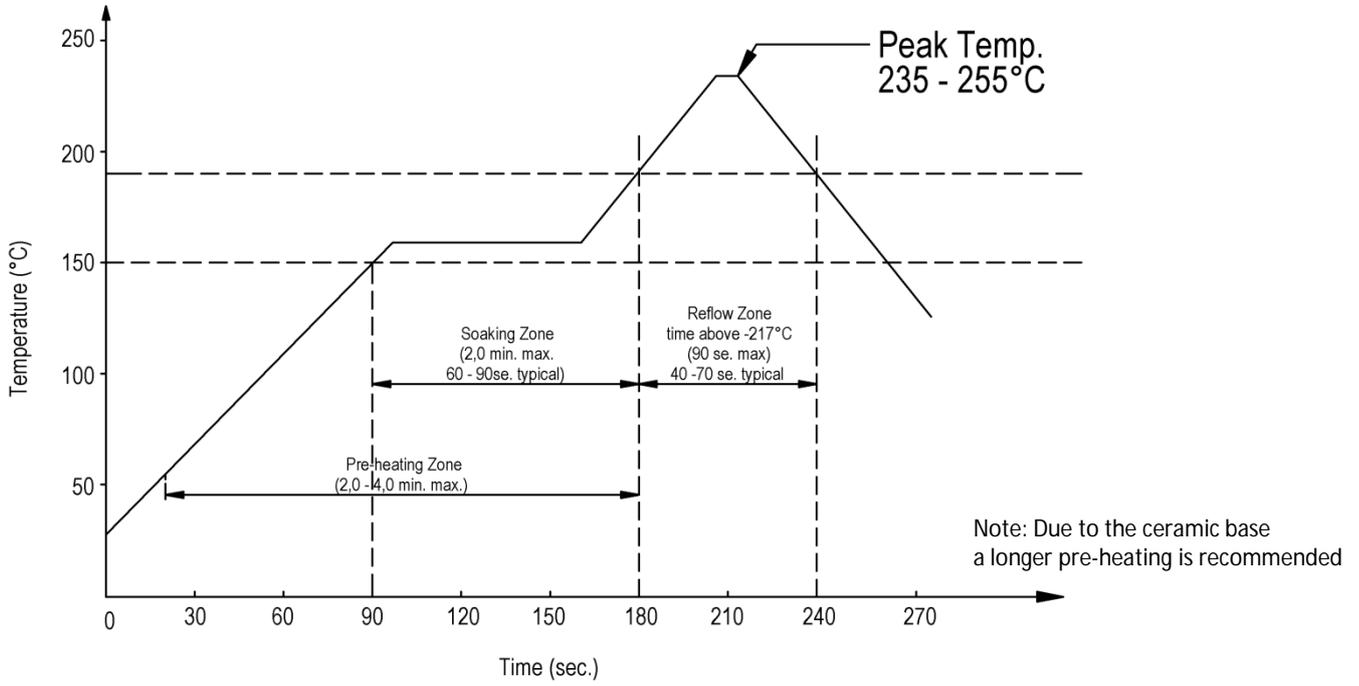


接点形式	
フォームA	NO = 常開接点 SPST = 単極単投接点
フォームB	NC = 常閉接点 SPST = 単極単投接点
フォームC	切替接点 SPDT = 単極双投接点
フォームE	ラッチング接点 自己保持型
“フォームA”のみ	

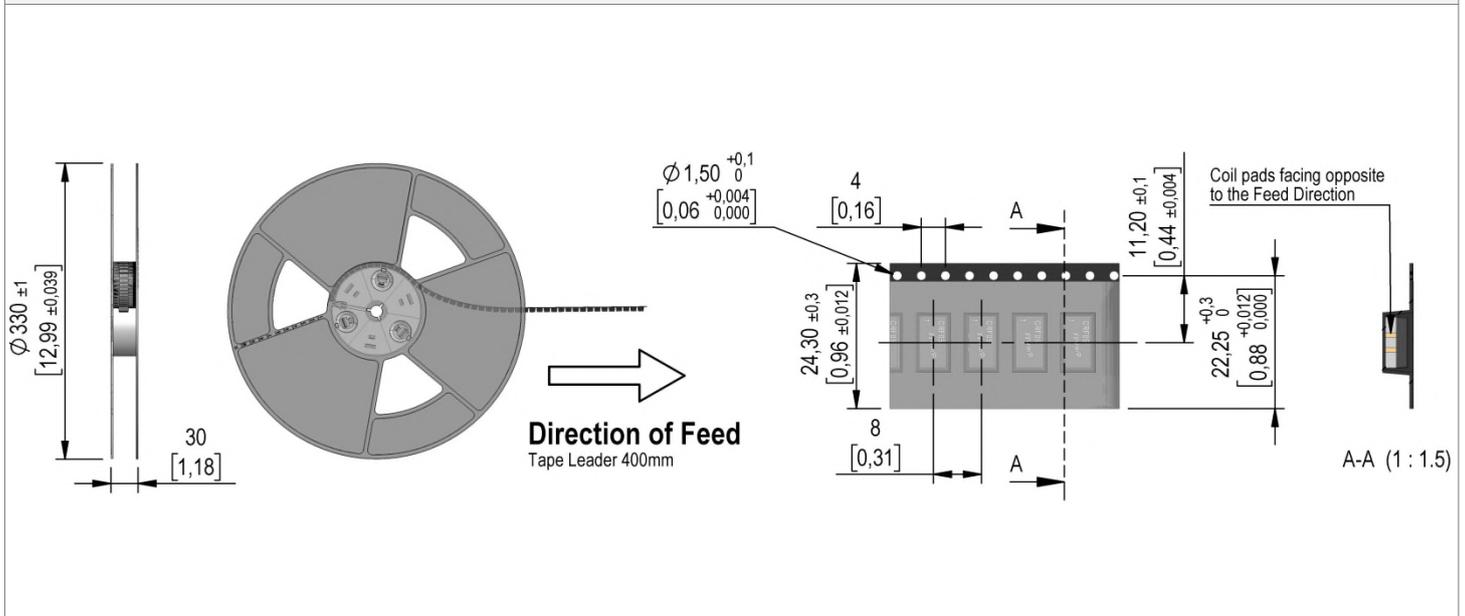
オプション	
CRF Basic	同軸および磁気シールドあり、ダイオードなし
L	標準、ダイオードなし
D	ダイオードあり
M	磁気シールドあり、ダイオードなし
Q	ダイオード及び磁気シールドあり
HR	高抵抗コイル
“Basic”オプションのみ	

推奨リフロープロファイル (JEDEC J-STD-020D.1)

Sn96.5/Ag3/Cu0.5 lead-free solder



包装形態: 1000個および250個/T&R (下図参照)



Please note: All technical specifications on this series datasheet refer to the standard product range. Modifications in the sense of technical progress are reserved. For general information only. For more specific information, please consult the product datasheet, available upon request.

This series datasheet could contain technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein. These changes will be incorporated in future revisions.

For deviating values, latest specifications and product details, please contact your nearest sales office.